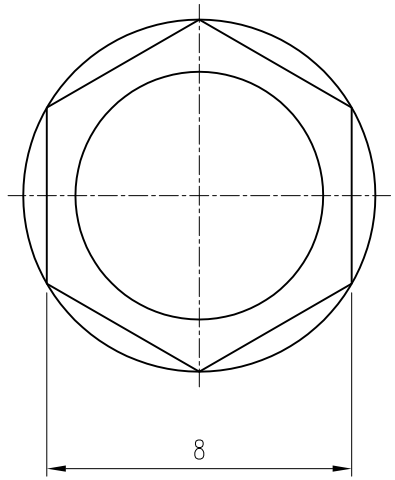
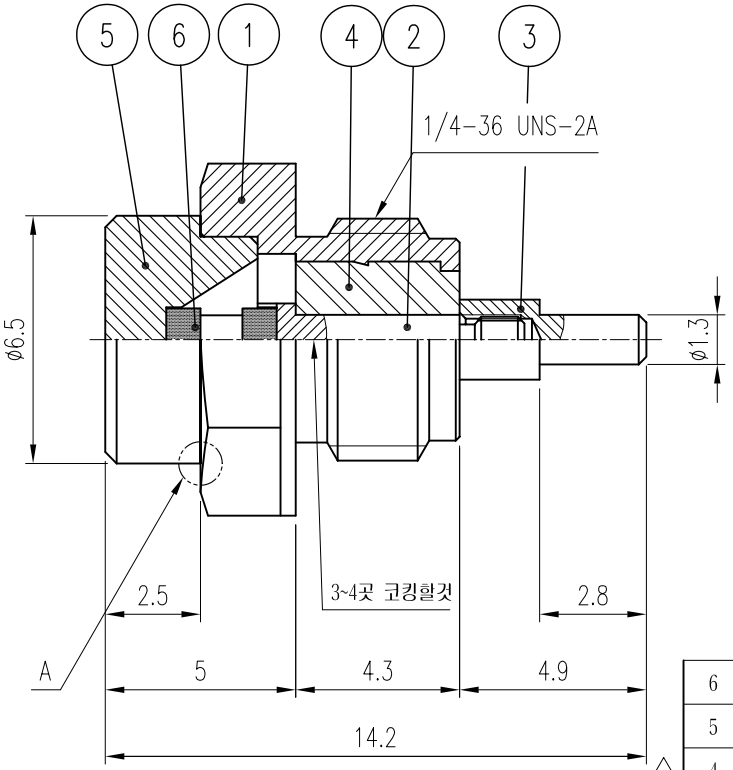
수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
1	신뢰성향상(설변NO. 연구2007-126) (절연체 변형에 의한 변경)	최유나	윤상진	2007. 07. 18.

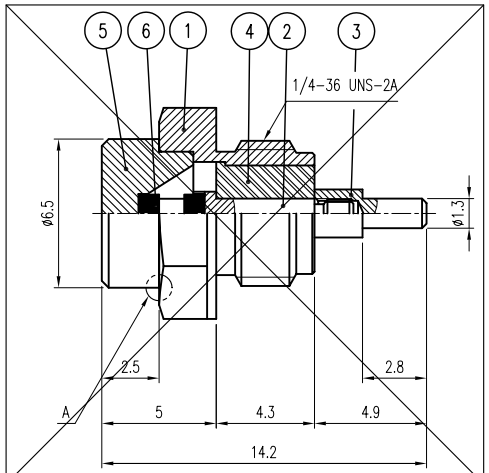
가공 / ST										
ST(기존)										
ST(개선)										





주 기

1. CONTACT(A) 와 CONTACT(B)를
   나사 체결시 LOCK TITE를 발라준다.
2. A부분 밀착 시킬 것(억지끼움).
3. 멀티미터기로 순수 저항 값을 측정할 것.
   (저항값 48~50Ω)



1 설변 전 VER.0

품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
6	RESISTOR	1			DRE00057-N/1 (XA118)
5	COVER	1	MBsBD	Gold Plate	DCV00013-5/1 (L2032)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00255-N/1 (H2320)
3	CONTACT(B)	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00123-5/1 (E2399)
2	CONTACT(A)	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00121-5/1 (E2482)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01343-5/1 (D2457)

1

대체가능재질

공통공차
.* ±0.1
.** ±0.05

재질

열처리

보호피막처리

년월일 2005. 11. 25.

승인

검도

제도

직성부서 연 구 소

척도 5/1 단위 mm 중량

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.

RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 SMA-J-내장형 TERM VER.1

A4

도번 TM00028-7/1

K314-953-001